



Pasta térmica de alto rendimiento diseñada para overclocking o PC gaming. Fácil de aplicar, rellena a la perfección el espacio entre tu CPU y su disipador. Nanotecnología en la pasta para mejorar la conducción de calor a través de micro moléculas. Hecha con materiales no conductores, esta pasta térmica es completamente segura de utilizar. Incluye un dosificador para una aplicación fácil y rápida.

Especificaciones

Modelo	Cog-4g
Conductividad térmica	>8.5 W/m-K
Impedancia térmica	<0.0016 °C-in ² /W
Gravedad específica	>3.25
Viscosidad	1000
Índice tixotrópico	330 ±10
MBT	-50~340°C
OT	-30~280°C
Ingredientes	
Compuestos de silicona	30%
Compuestos de carbono	20%
Compuestos de óxido	50%
Peso	
Peso neto	4g

Garantía

1 año

Prestaciones

1. Fórmula de pasta térmica especialmente diseñada para overclocking o PC gaming
2. Fácil de aplicar, rellena a la perfección el espacio entre tu CPU y su disipador
3. Nanotecnología para mejorar la conducción de calor
4. Materiales no conductores para asegurar un uso seguro
5. Incluye un dosificador para una aplicación rápida y fácil
6. Viene con 4g de pasta térmica Comes with 4g thermal paste



Información de paquete

Nombre del producto	Número del producto	Código EAN	Código UPC
Cog-4g	ACTG-NA64210.01	4710562755503	

Tamaño del paquete (L x W x H)		Peso del paquete	
Tamaño caja retail (L x W x H)		Peso caja retail	
Cantidad paquete		Cantidad pallet	
FTP for pictures download:			